



2026/02

景美科技 (CMAT)

全球信賴的半導體測試介面核心專家

先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造

Certain Micro Application Technology
INVESTOR CONFERENCE

7899.TW

興櫃掛牌：2026年2月25日(半導體類股)

免責聲明

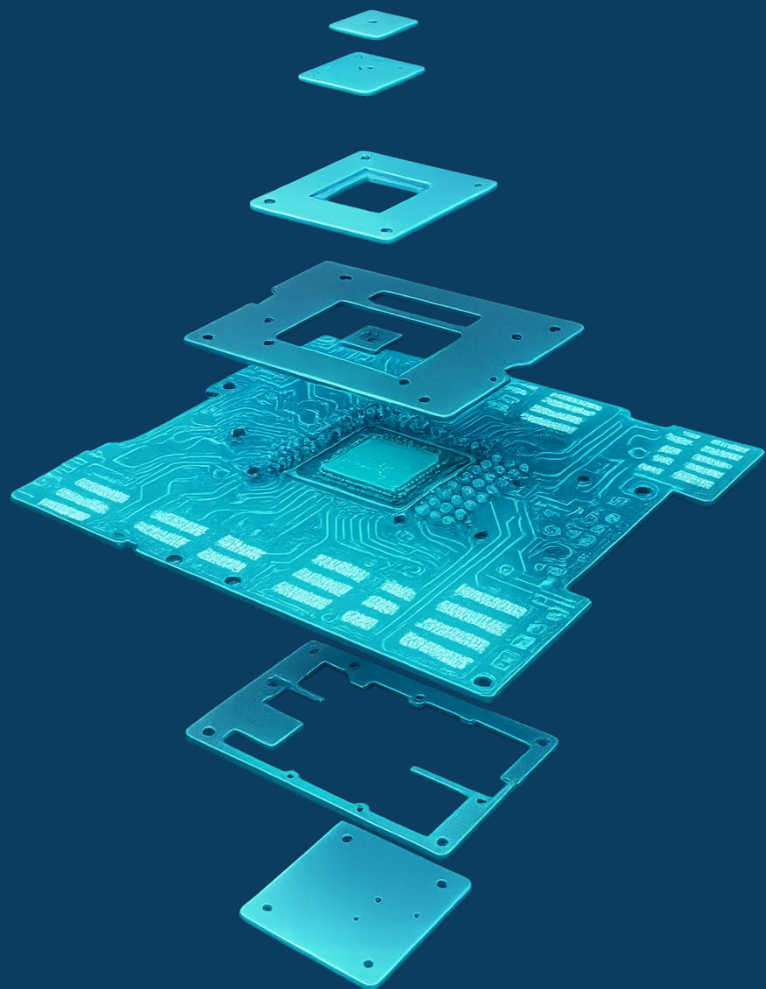


- 除過去資料外，本簡報資料所列事項若為前瞻性看法，可能受重大風險和不確定性因素影響而與實際結果有所差異。
- 本簡報中如有對未來之展望，係反映本公司截至目前為止對於未來之看法，如未來有因任何事件或環境變遷，本公司並不負有更新資料之責任。
- 本簡報所作有關本公司財務上、業務上、Q&A之說明，可能與未來實際結果存有差異。其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 未經本公司許可，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容用於商業用途。

7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

Content



- 1 公司簡介
- 2 市場觀點
- 3 財務資訊
- 4 投資亮點
- 5 參考資料

7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



公司簡介

01

景美科技 二十年深耕，成就不可取代的產業地位



2006

景美科技CMAT公司設立



2007

- 取得ISO認證
- TSMC合格供應商



2013

- 由探針卡供應商轉型為先進製程探針卡結構件供應商



2020

- 取得FormFactor、穎崙、中華精測合格供應商資格



2021

- TSMC ATE Stiffener 驗證通過 (美系測試機)



2023 / 2024

- 取得旺矽合格供應商資格



2025

- TSMC ATE Stiffener 驗證通過 (日系測試機)
- 雷射微鑽孔驗證通過

積極擴充產能，以滿足未來先進製程的爆發性需求

公司概况與產能擴充計畫

資本額：2.29 億元 董事長：陳吉良 總經理：羅麗文

關鍵資訊



營運總部：台灣(土城)



集團員工人數：139人
(研發人員佔比15%)

產能擴充里程碑



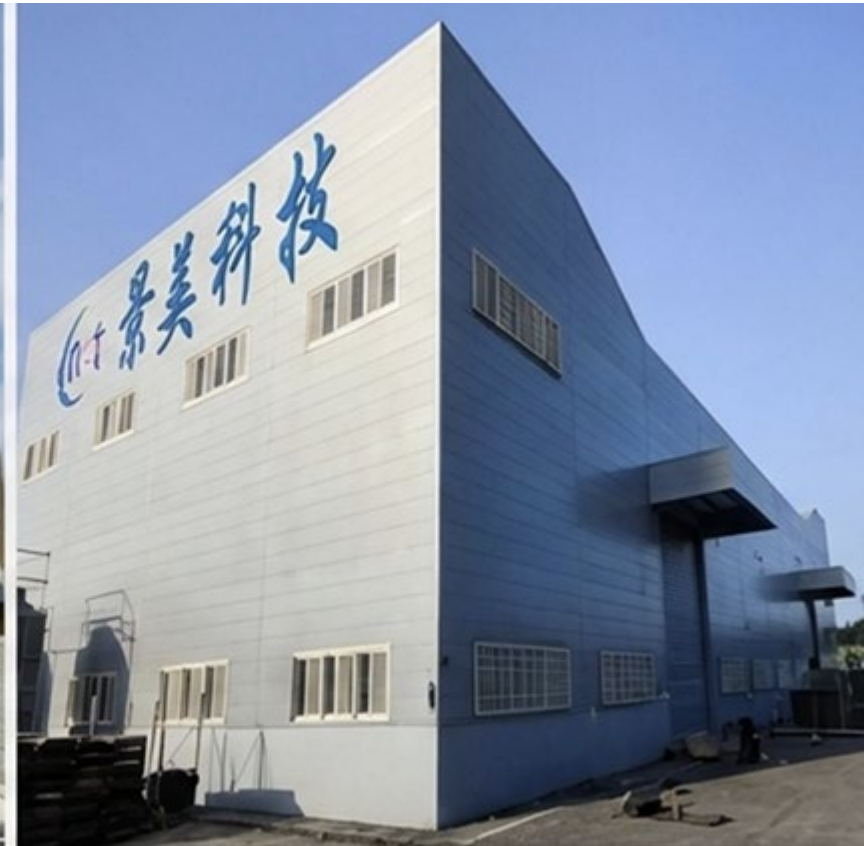
宜蘭利澤一廠：已啟用 (2021)



宜蘭利澤二廠：已啟用 (2023)



宜蘭利澤三廠：將啟用 (2028)



擴產計畫是為了因應~未來幾年由AI驅動的市場增長需求

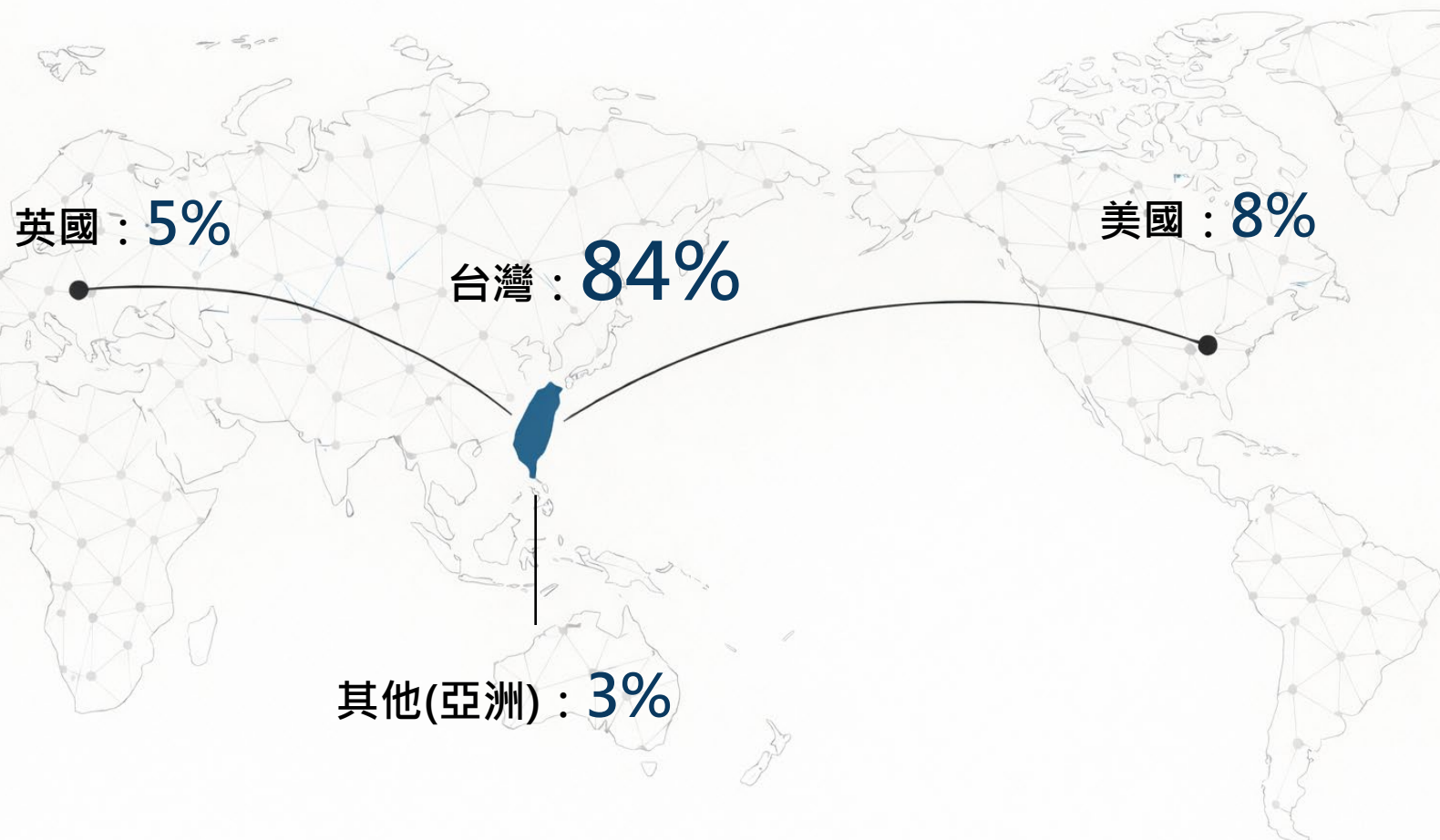
立足半導體聚落，服務全球頂尖客戶



未來五年先進製程產能，
近八成仍在台灣。

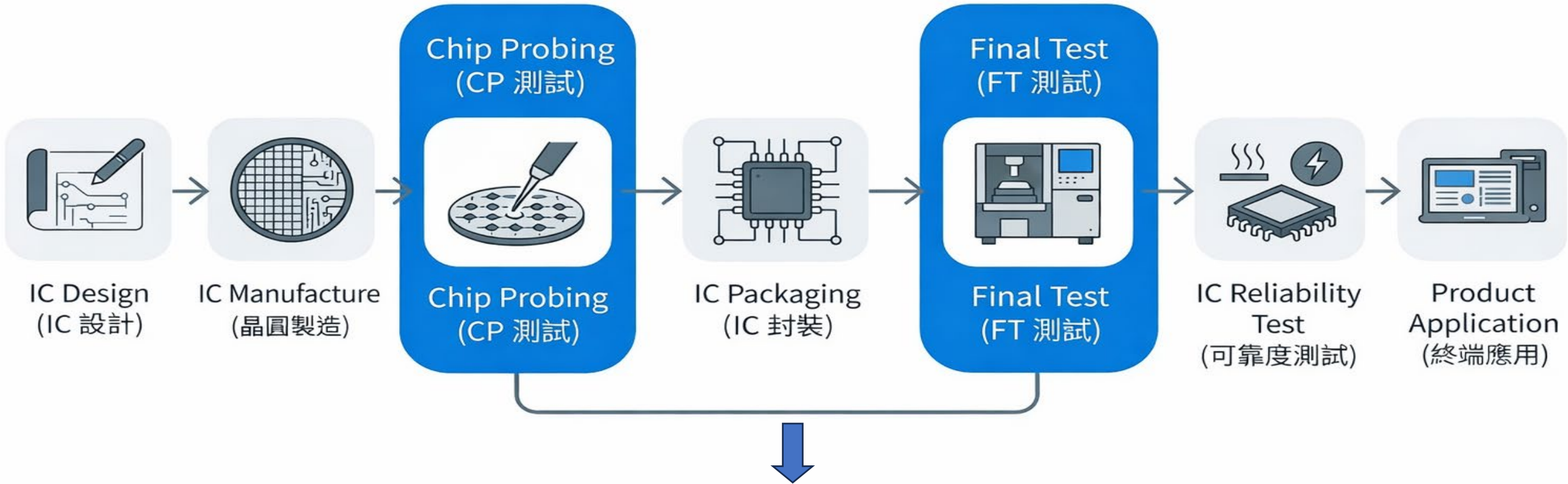


我們的擴產計畫與客戶
的發展藍圖緊密結合，
確保能就近提供最即時、
最深度的服務。



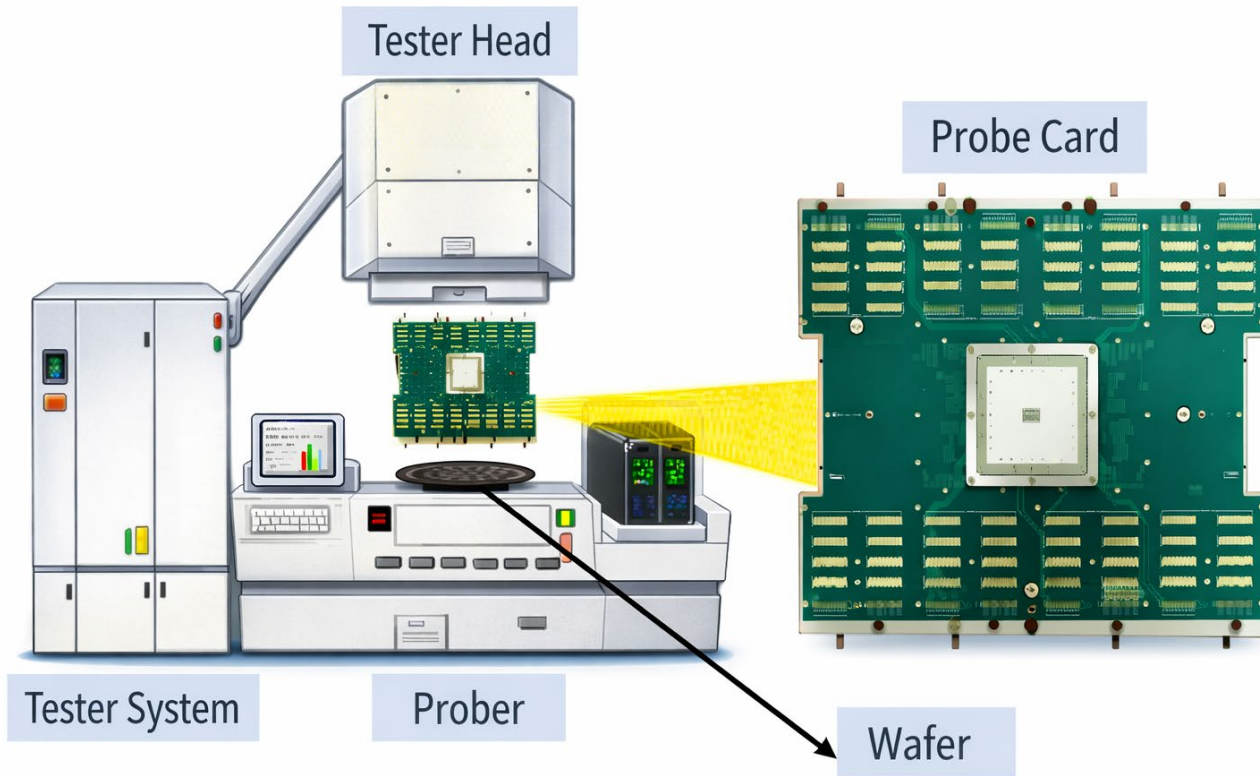
景美科技產品 IC 產業鏈之位置

晶圓前段CP 及 後段測試FT的關鍵節點



「核心產品：探針卡結構件為關鍵優化節點」

為最先進的晶片測試 提供不可或缺的精密基礎



核心業務

先進製程探針卡-- 結構件設計製造

我們設計和製造探針卡中的關鍵結構件，確保數以萬計的微細探針能夠在微米級的精度下穩定運作。

先進製程探針卡-- 微細鑽孔加工

我們的精密鑽孔技術是實現高密度、高頻寬的基礎，對AI 和 GPU晶片至關重要。

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



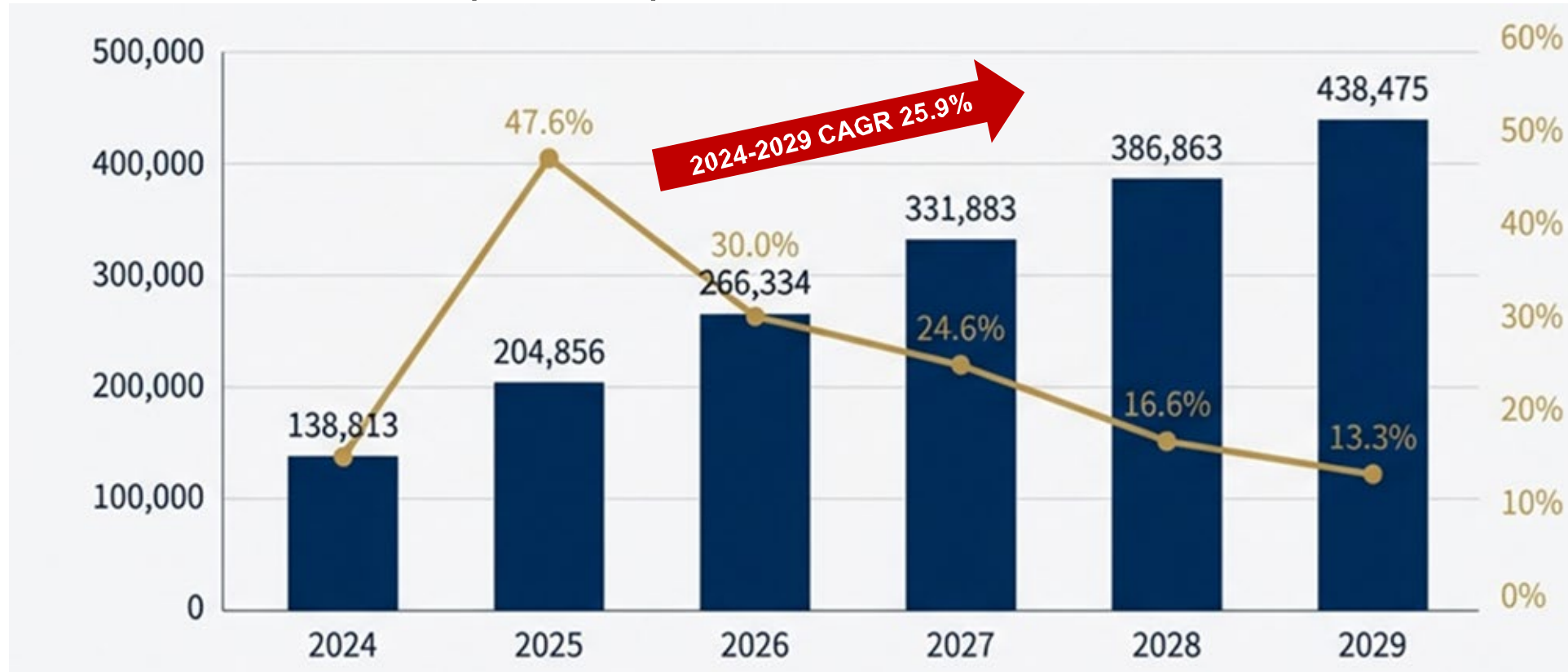
市場觀點

02

AI革命掀起滔天巨浪，半導體需求呈指數級成長

AI應用的爆發性需求是未來五年半導體最關鍵的成長動能。

全球AI半導體市場規模(百萬美元)



預估至2029年，市場規模將達4,385億美元，2024-2029年複合成長率高達25.9%。

AI應用將是未來五年晶圓代工產業最關鍵成長動能

| 晶圓代工營收影響因素 | | 2025 | 2026 | 2027~2030年 |
|------------|--|-------|-------|------------|
| 需求面 | 雲端AI應用帶動AI加速器與AI ASIC需求動能。 | ↑★★★★ | ↑★★★★ | ↑★★★ |
| | 邊緣AI落地，首波聚焦手機、NB/PC、智慧眼鏡，智慧家庭、工業應用等仍待時間發酵。 | ↑★ | ↑★ | ↑★★★ |
| | IDM委外代工需求趨勢穩定。 | ↑★ | ↑★ | ↑★ |
| | 地緣政治不確定性干擾晶片需求。 | ↑★ | ↓★ | - |
| | IC載板材料缺貨可能影響部分產品出貨。 | ↓★ | ↓★ | - |
| 供給面 | 5奈米及以下先進製程持續挹注營收成長。 | ↑★★★★ | ↑★★★★ | ↑★★★ |
| | 先進封裝技術滿足客戶高階AI晶片需求。 | ↑★★★ | ↑★★★ | ↑★ |
| | 中國半導體自主化發展，成熟製程產能續開出。 | ↑★ | ↑★ | ↑★★★ |
| | 美國續執行半導體出口管制，抑制中國先進製程供給。 | ↓★ | ↓★ | ↓★ |

註：影響該年營收程度，↑表示有正向影響，↓表示有負向影響，★越多表示影響性越大，-表示無影響或待觀察。

資料來源：DIGITIMES，2025/11

全球半導體探針卡規模 預計2029年增長至近40億美元



複合年增長率顯示強勁動能，顯示TechInsights 與Yole市場共識數據



2024 年度全球半導體前十大探針卡廠商市場佔有率

| TechInsights : 2024 年度 | | | |
|------------------------|----------------------------|-------|--------|
| 排名 | 廠商名稱 | 國家/地區 | 市占率 |
| 1 | FormFactor | 美國 | 23.58% |
| 2 | Technoprobe | 義大利 | 22.22% |
| 3 | MJC | 日本 | 13.33% |
| 4 | 旺矽科技 | 臺灣 | 7.38% |
| 5 | JEM | 日本 | 4.74% |
| 6 | 強一股份 | 中國大陸 | 3.25% |
| 7 | Nidec SV Probe Pte. Ltd. | 新加坡 | 2.81% |
| 8 | Korea Instrument CO., Ltd. | 韓國 | 2.47% |
| 9 | TSE CO., Ltd. | 韓國 | 2.16% |
| 10 | 思達科技股份有限公司 | 臺灣 | 1.93% |
| 合計 | - | - | 83.86% |

| Yole : 2024 年度 | | |
|----------------------------|-------|--------|
| 廠商名稱 | 國家/地區 | 市占率 |
| FormFactor | 美國 | 24.90% |
| Technoprobe | 義大利 | 16.31% |
| MJC | 日本 | 13.87% |
| 旺矽科技 | 臺灣 | 7.74% |
| JEM | 日本 | 4.93% |
| 強一股份 | 中國大陸 | 3.42% |
| Korea Instrument CO., Ltd. | 韓國 | 2.77% |
| TSE CO., Ltd. | 韓國 | 2.24% |
| 思達科技股份有限公司 | 臺灣 | 2.11% |
| Nidec SV Probe Pte. Ltd. | 新加坡 | 2.03% |
| - | - | 80.30% |

全球信賴的半導體測試介面核心專家
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

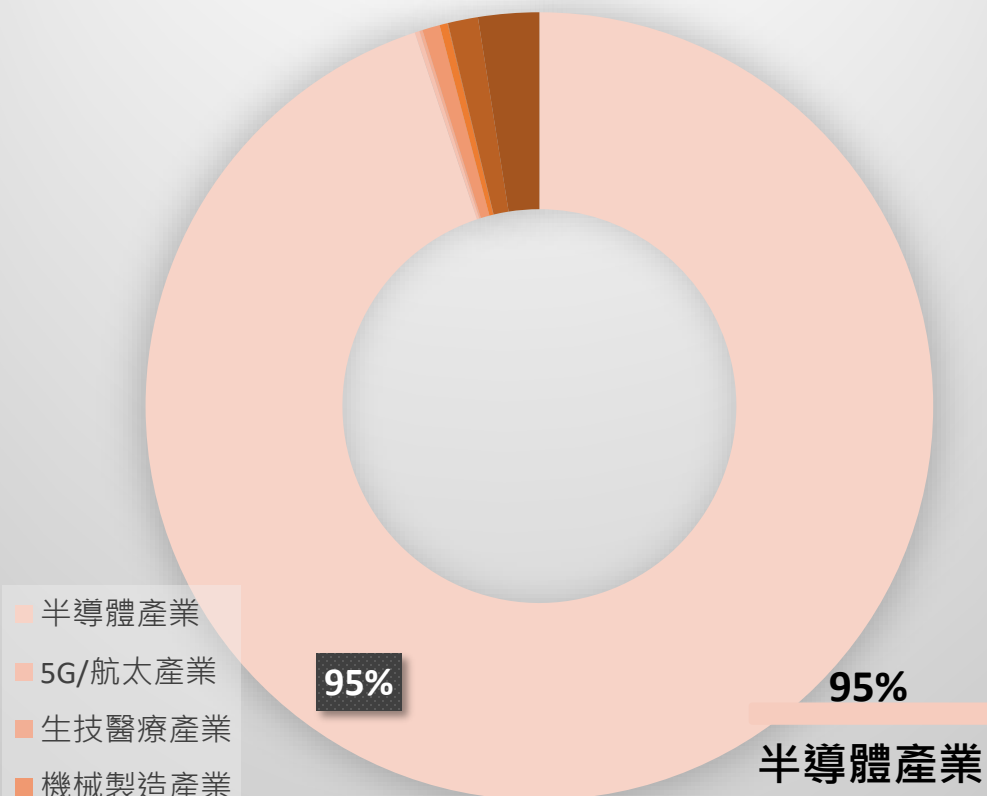
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



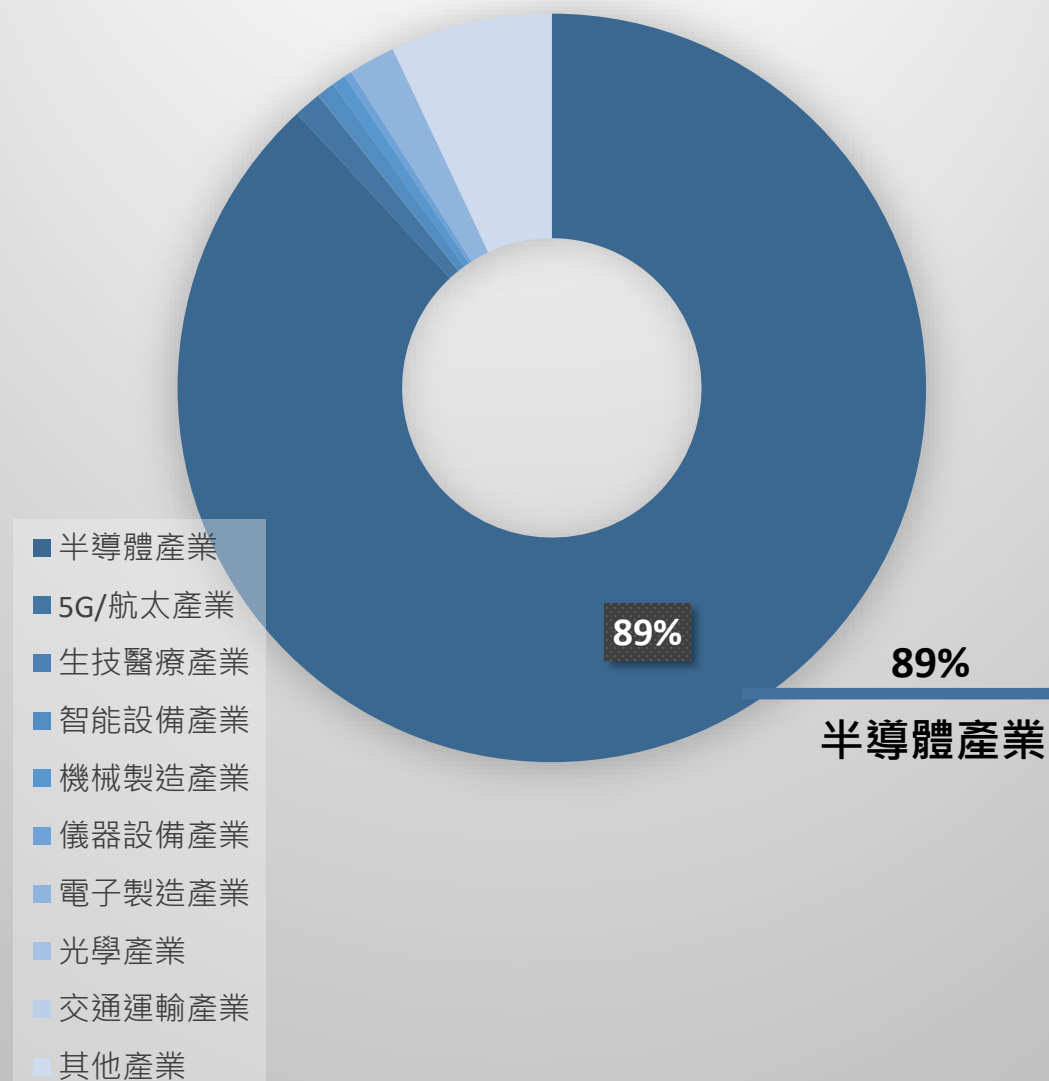
財務資訊

03

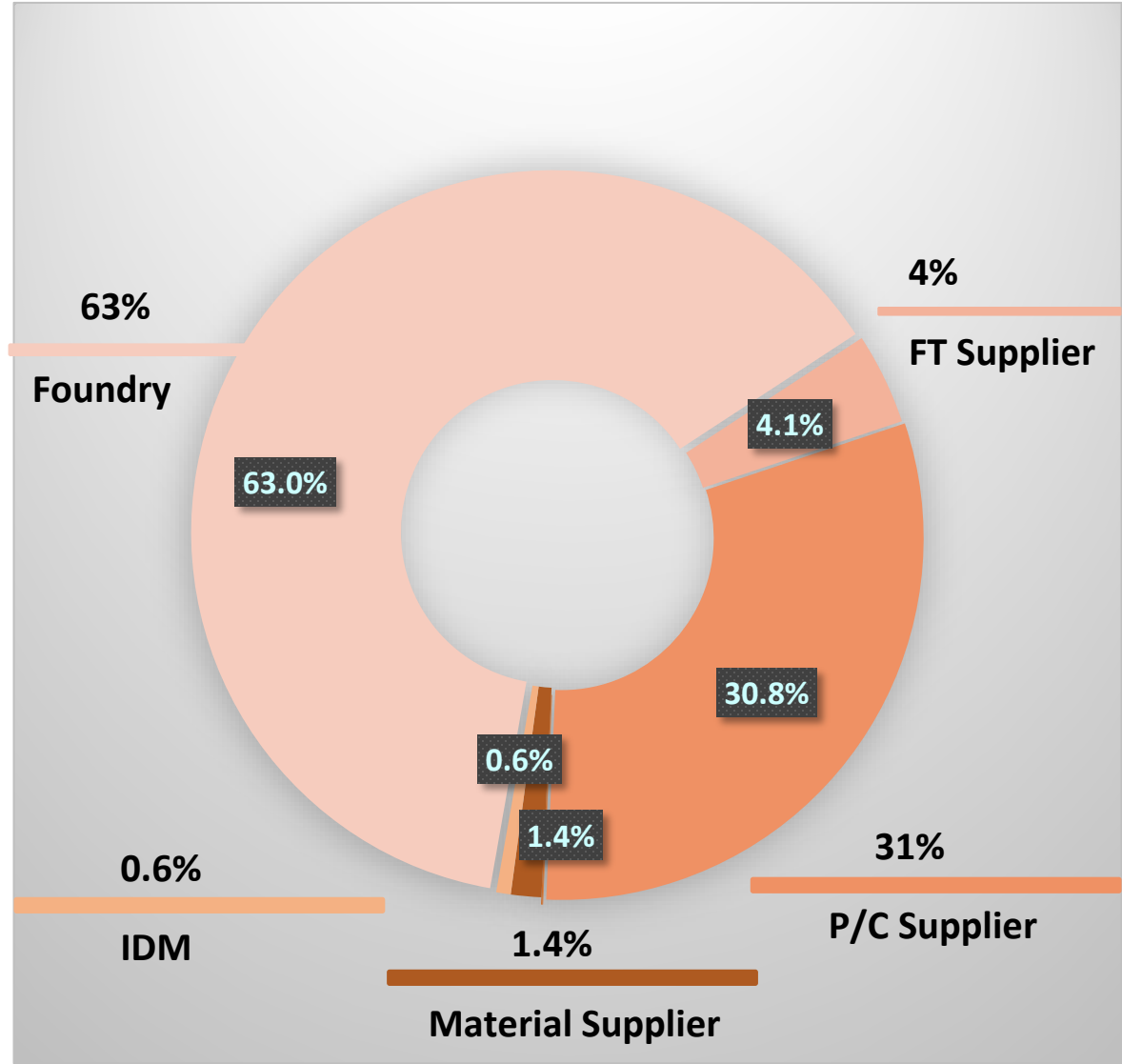
2024 客戶產業別占比



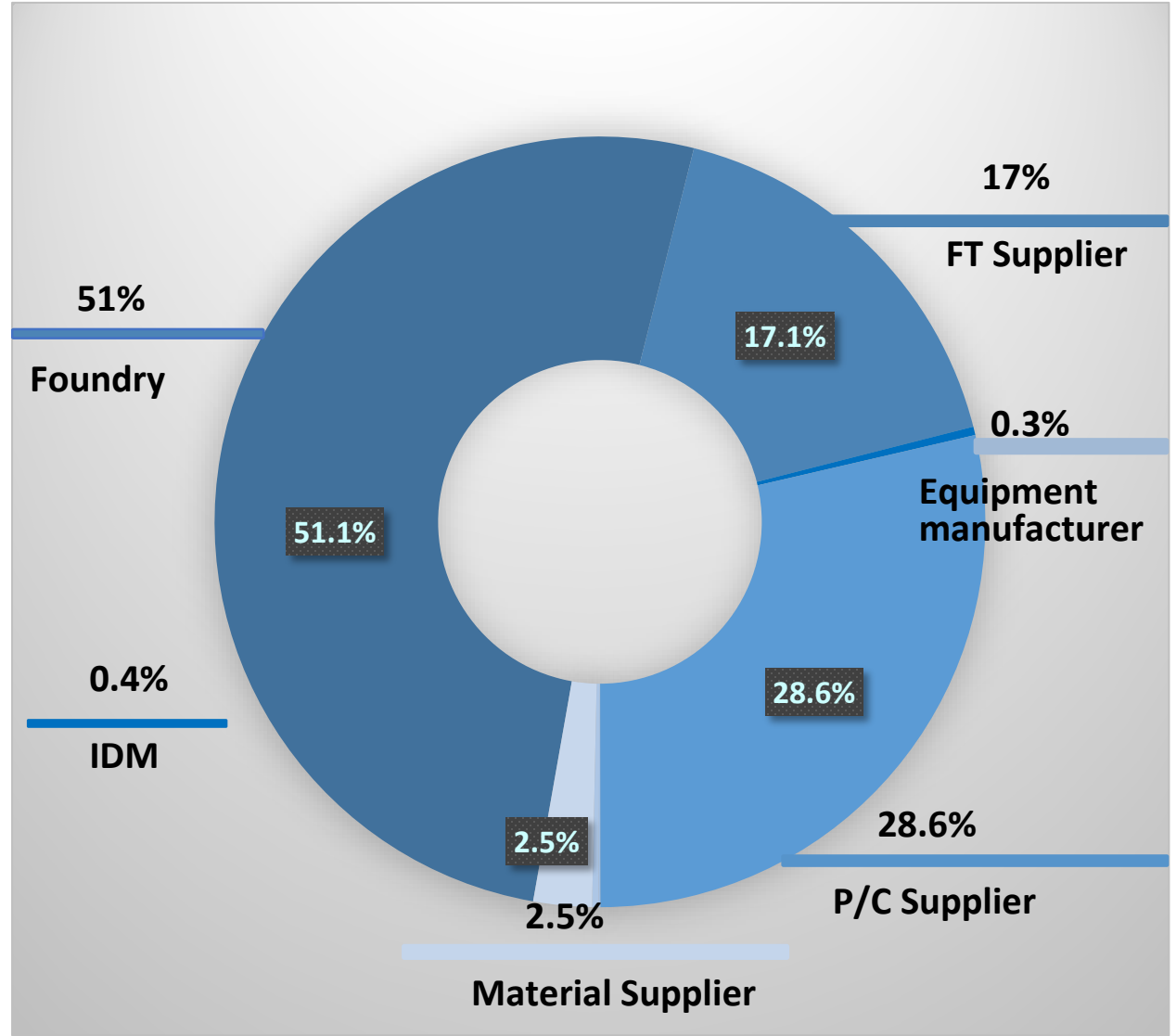
2025 客戶產業別占比



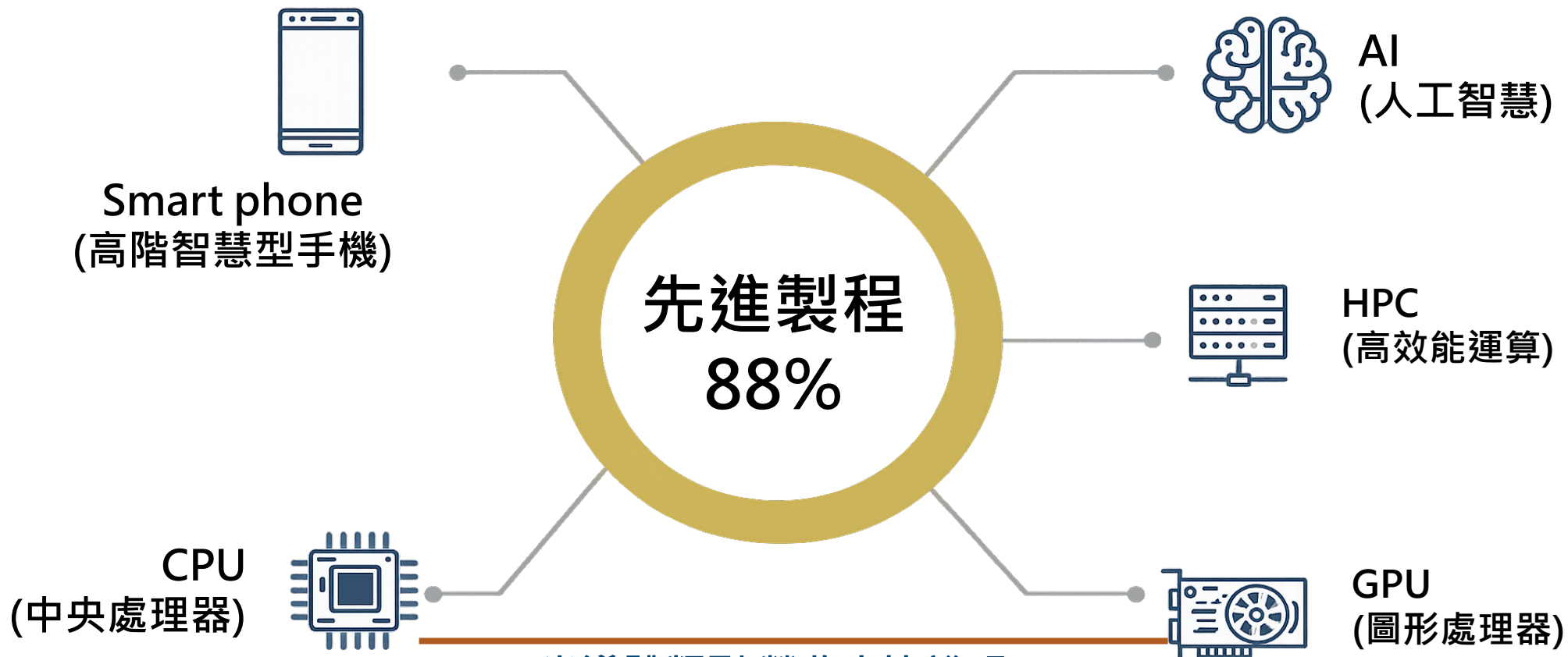
2024年 營收95% 半導體客戶類型



2025年 營收89% 半導體客戶類型



營收高度集中於先進製程，直接受惠於AI與HPC的強進需求



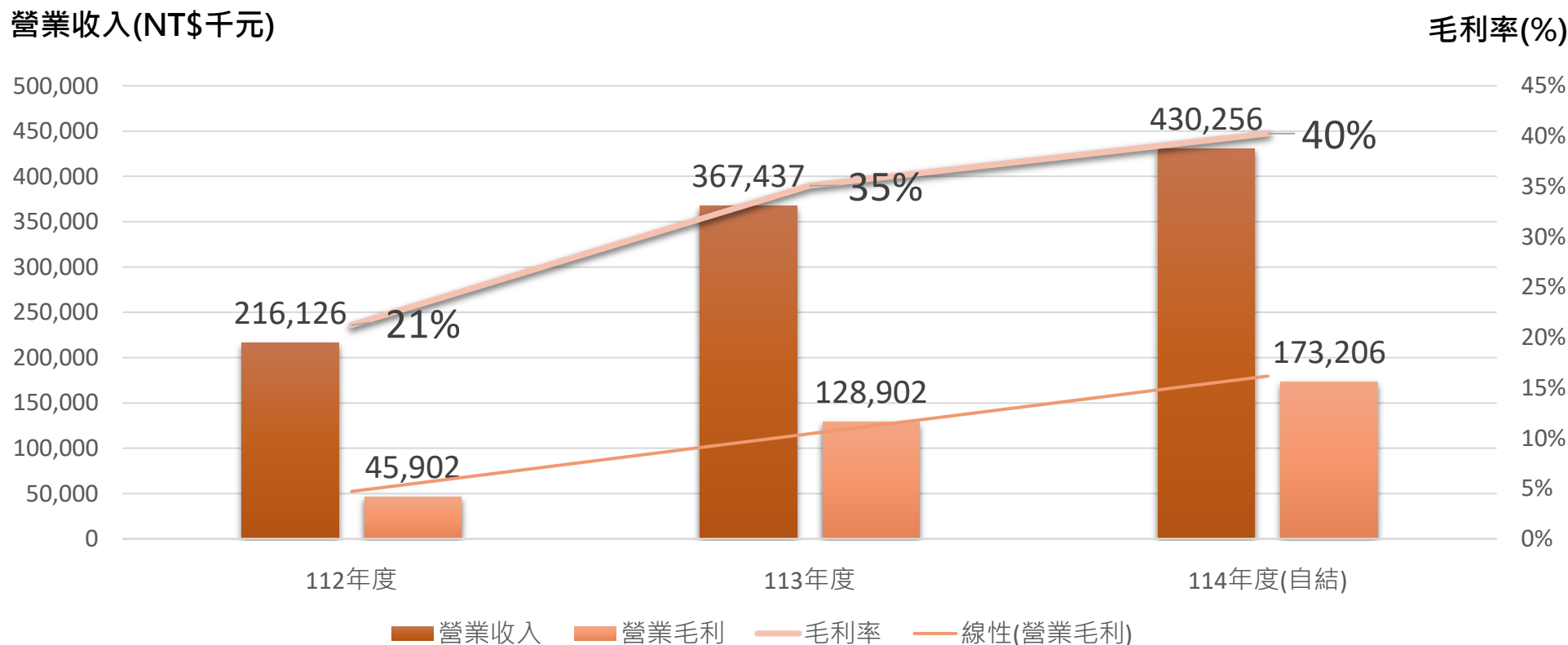
半導體類型 營收占比說明

先進製程 (Advanced Node) : 88%

成熟製程 (Mature Node) : 9%

其他 (Other) : 3%

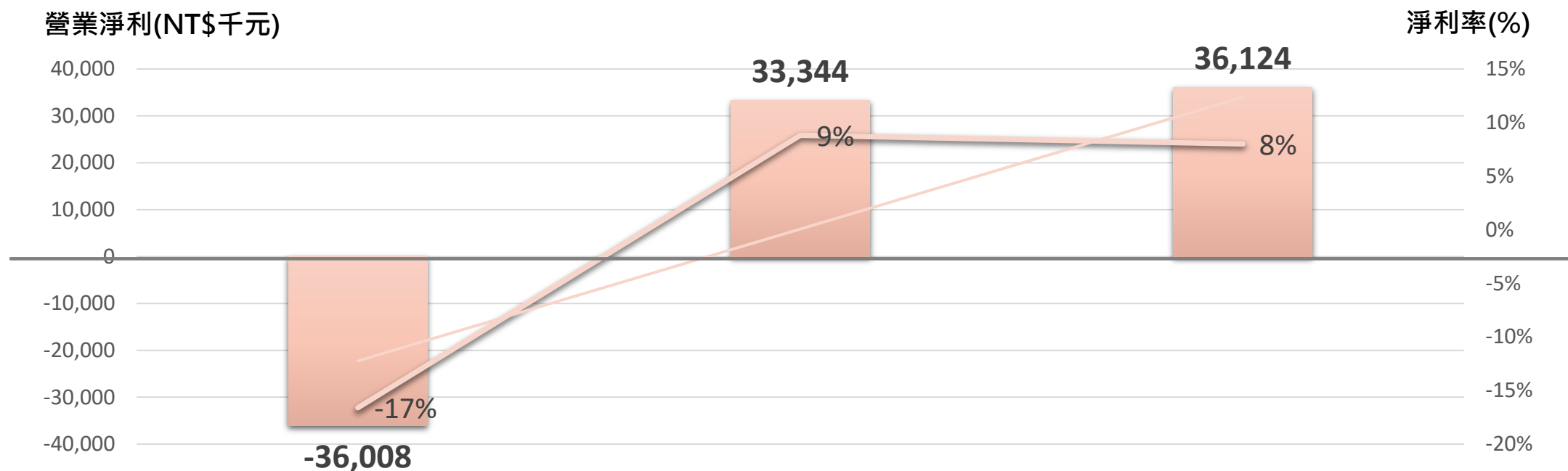
合作深化帶動營收成長 高附加價值推升毛利率



| (單位: 新台幣仟元) | 112年度 | 113年度 | 114年度(自結) |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 營業收入 | 216,126 | 367,437 | 430,256 |
| 營業毛利 | 45,902 | 128,902 | 173,206 |
| 毛利率 | 21% | 35% | 40% |

「營收與毛利結構同步增長，展現強勁成長趨勢」

規模經濟與營運效率提升 實現淨利率由負轉正的顯著改善



| (單位: 新台幣仟元) | 112年度 | 113年度 | 114年度(自結) |
|-------------|----------|--------|-----------|
| 營業淨利 | (36,008) | 33,344 | 36,124 |
| 淨利率 | (17%) | 9% | 8% |

「公司已進入穩定獲利軌道，未來獲利能力具備持續上升空間」

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



投資亮點

04

共創價值的成長飛輪



深度整合夥伴關係

- 研發服務：設計建議與協作 與 痛點解決方案
- 製造銷售服務：穩固訂單且維持長期的上、下游合作關係。

驅動多面向成長需求

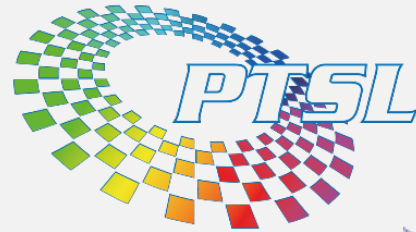
- 設計資源需求
- 產能需求
- 檢驗需求
- 專業夥伴的需求

實現共贏的商業價值

- 持續增加的NRE 及 組裝服務收入
- 持續成長的銷貨收入
- 其他設備及維修支援收入

「站在巨人的肩膀上，共創價值」

巨人們背後，有一群通過嚴苛考驗的頂尖夥伴

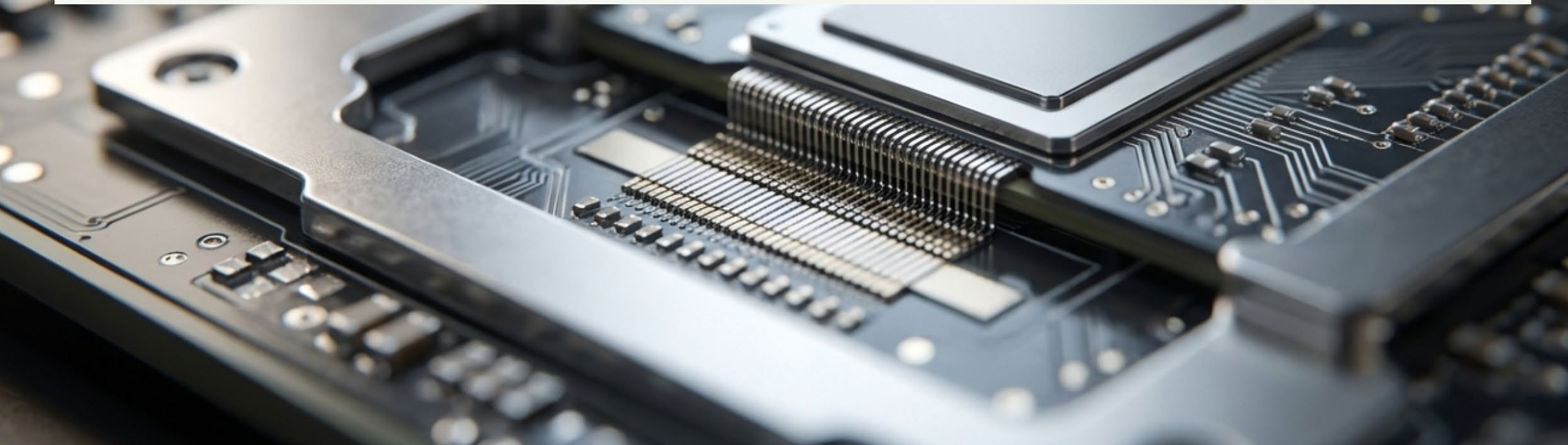


我們的技術，是業界巨擘創新里程的關鍵拼圖。

信賴，源自對技術與品質的絕對堅持。

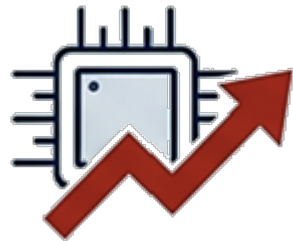


在這個要求零失誤的產業，信任無法輕易獲得。全球領導者的共同選擇CMAT，是因為我們的技術能力滿足最嚴苛的規格，我們的品質承諾確保了最穩定的表現。這不僅是合作，更是我們對核心能力的認可。



景美科技(CMAT): 長期價值的四大基石

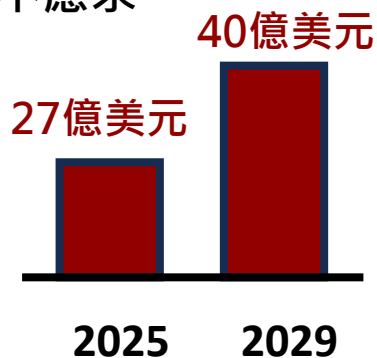
掌握先進製程關鍵，AI浪潮下的隱形冠軍



市場潛力

AI 與 HPC 強勁驅動

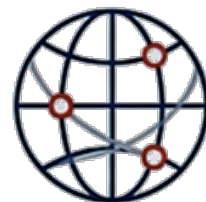
- 我們的技術是先進製程測試不可或缺的一環，直接受惠於AI蓬勃發展，市場供不應求。



技術護城河

研發製造一體

- 獲巨人客戶高度信賴，品質與交期穩定
- 建構不可輕易取代的產業門檻，驅動中長期成長動能



全球布局

探針卡廠最強後盾

- 以夥伴思維深度嵌入供應鏈，是客戶可信賴的製造延伸與技術後盾。
- 與台灣、美、英、日、韓探針卡大廠建立深度合作。



營運績效

獲利體質強健

40%

毛利率顯著提升

78%

先進製程產品營收占比

2028年啟用第三座廠區，
產能再升級

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

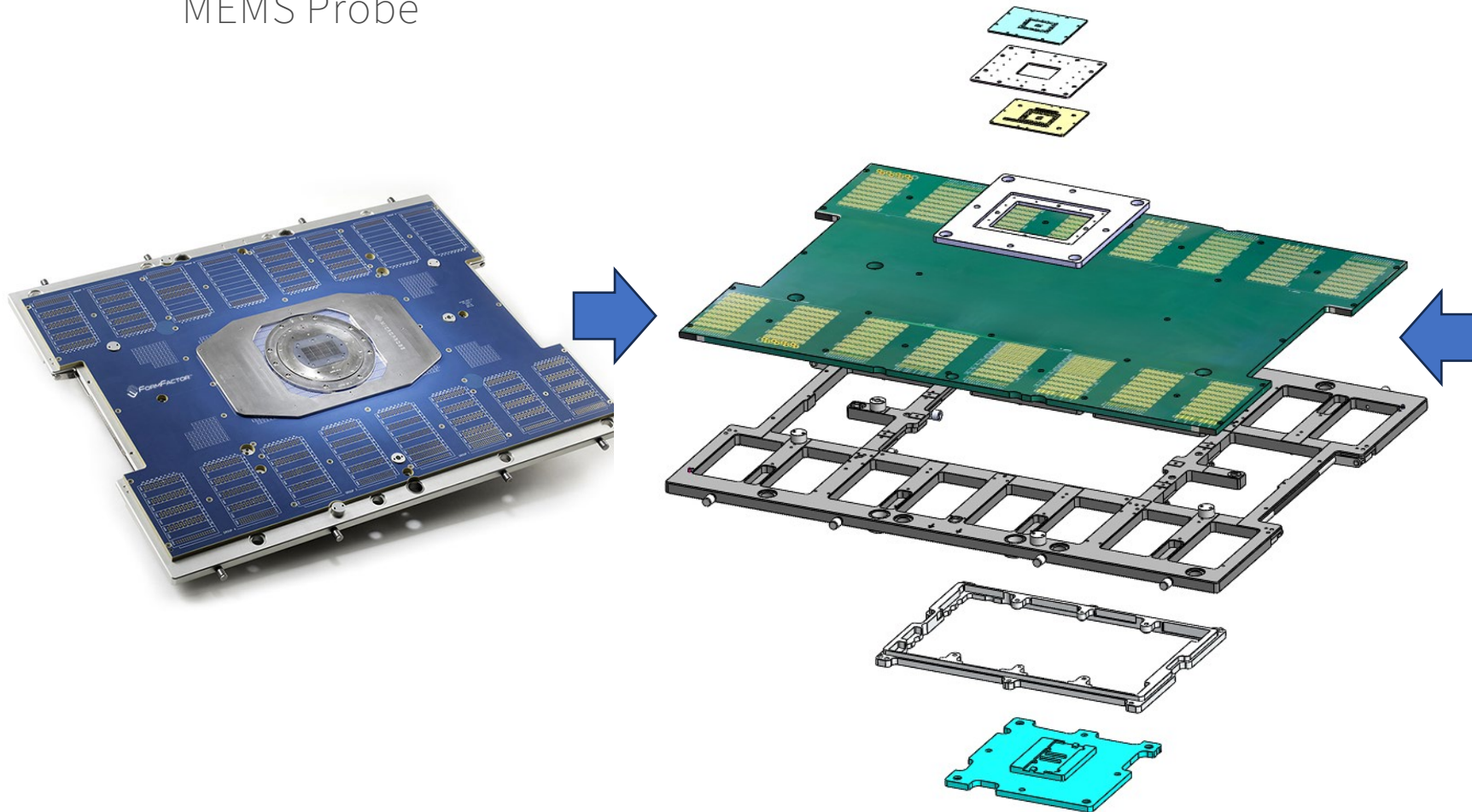


參考資料

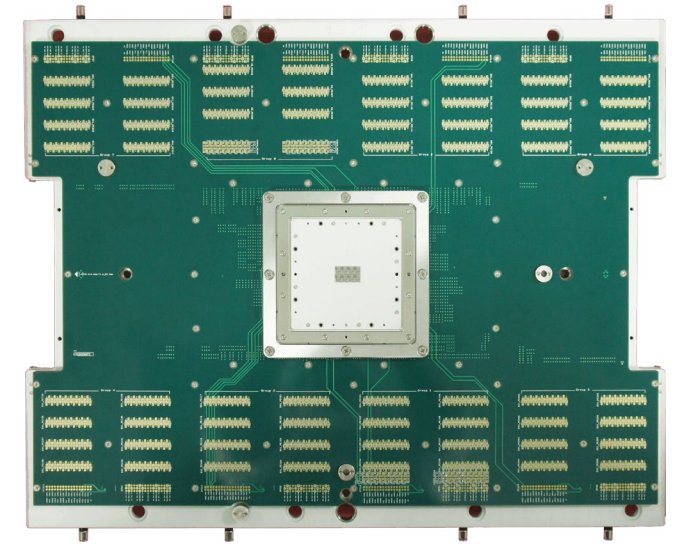
05

垂直式探針卡VPC

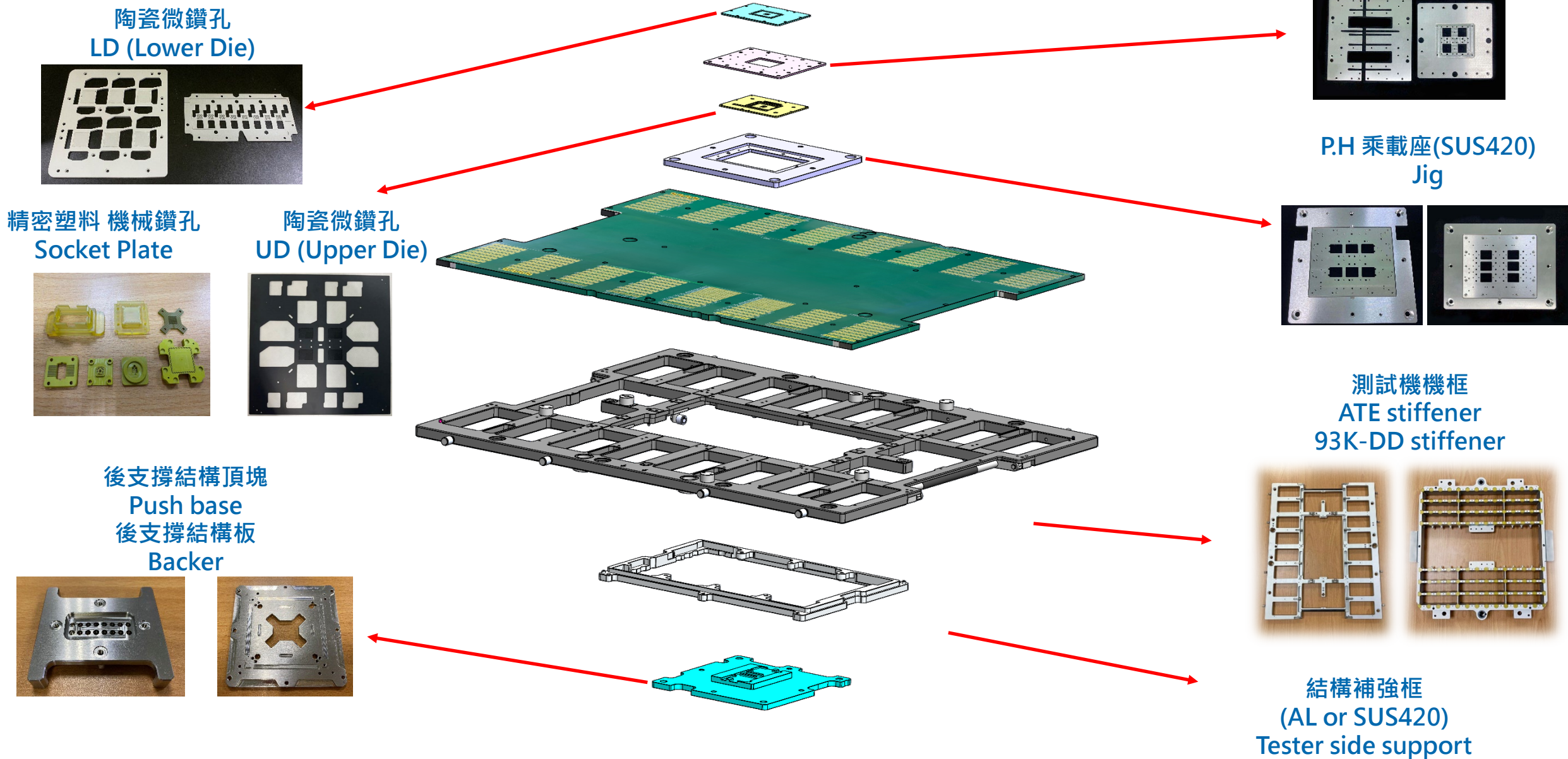
晶圓測試垂直探針卡 (VPC)
MEMS Probe



晶圓測試垂直探針卡 (VPC)
Cobra Probe



垂直式探針卡架構圖 (MEMS/Cobra)



未來五年台積電先進製程產能布建 近八成仍在台灣

2025~2030年積電先進製程產能布局狀況

| 業者 | 投資地點 | 廠區 | 製程 | 規劃月產能 (千片/12吋) | 量產時點 |
|-----|----------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| 台積電 | 台灣 新竹 | Fab 20 P1, P2 | N2/A16 | 100~120 | 4Q25 |
| | | Fab 20 P3, P4 | A14 | | 2028年 |
| | 台灣 高雄 | Fab 22 P1, P2, P3 | N2/A16 | 120~150 | 4Q25~2027 |
| | | Fab 22 P4, P5 | N2/A16 | | 2028年起 |
| | | Fab 22 P6 | A14 | 新案評估中 | 待定 |
| | 台灣 台中 | Fab 25 P1~P4 | A14/A10 | 100~120 | 2028年起 |
| | 美國 亞利桑那州 | Fab 21 P1 | N4 | 200~250 | 4Q24 |
| | | Fab 21 P2 | N3/N2 | | 2027/2028年 |
| | | Fab 21 P3 | N2/A16 | | 2029~2030年 |
| | | Fab 21 P4 | N2/A16 | | 待定 |
| | | Fab 21 P5、P6 | A14/A10 | | 待定 |
| | 日本 熊本 | Fab 23 P2 | N6 | 50 | 2027→2028年 |

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



Q&A



7899.TW

Thanks

景美科技 (CMAT)

全球信賴的半導體測試介面核心專家

先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造